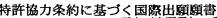
特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2003年03月27日 (27.03.2003) 木曜日 18時27分25秒

CF017145W0

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2003年03月27日 (27.03.2003) 木曜日 18時27分25秒

111-1	その他の出願人又は発明者	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
111-1-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and
		inventor)
I I I -1 -2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-1-4j	ある。 氏名(姓名)	木須 浩樹
III-1-4e	Name (LAST, First)	KISU, Hiroki
	あて名:	146-8501 日本国
III-1-5e n	Address:	東京都 大田区 下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 c/o CANON KABUSHIKI KAISHA 3-30-2, Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo 146-8501 Japan
111-1-6	国籍(国名)	日本国 JP
111-1-7	住所(国名)	日本国 JP
111-2 111-2-1	その他の出願人又は発明者	NUMBER OF THE PROPERTY OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPE
111-2-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and
111-2-2	右の指定国についての出願人で	inventor) 米国のみ(US only)
[] [-2-4 j	ある。 氏名(姓名)	村井 啓一
III-2-4e	Name (LAST, First)	MURAI, Keiichi
! ! I I - 2 - 5 j	あて名:	146-8501 日本国
111-2-5e n	Address:	東京都 大田区 下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 c/o CANON KABUSHIKI KAISHA 3-30-2, Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo 146-8501 Japan
111-2-6	国籍 (国名)	日本国 JP
111-2-7	住所 (国名)	T T T T T T T T T T
111-3	その他の出願人又は発明者	
I I I -3-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
I I I -3-2	右の指定国についての出願人である。	
III-3-4j	氏名(姓名)	宮町 尚利
a -3-4e	Name (LAST, First)	MIYAMACHI, Naotoshi
n -3-5 j	あて名:	146-8501 日本国
a 	Address:	東京都 大田区 下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 c/o CANON KABUSHIKI KAISHA 3-30-2, Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo 146-8501
111-3-6	国籍(国名)	Japan 日本国 JP
111-3-7	住所(国名)	日本国 JP
	1	INTEL



特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2003年03月27日 (27.03.2003) 木曜日 18時27分25秒

IV-I	代理人又は共通の代表者、通	
	知のあて名 下記の者は国際機関において右	(h. 700 (
	記のでとく出願人のために行動	代理人 (agent)
	する。	
1V-1-1ja	氏名(姓名)	岡部 正夫
IV-1-1en	Name (LAST, First)	OKABE, Masao
IV-1-2ja	あて名:	100-0005 日本国
	·	東京都 千代田区
		丸の内3丁目2番3号
		富士ビル602号室
IV-1-2en	Address:	No. 602, Fuji Bldg.
		2-3, Marunouchi 3-chome
		Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
17-1-3	電話番号	Japan 03-3213-1561
IV-1-4	型の番々 ファクシミリ番号	03-3213-1361
TV-2	その他の代理人	
	での他の代理人	筆頭代理人と同じあて名を有する代理人 (additional agent(s) with same address as
		first named agent)
IV-2-1 j a	氏名	加藤 伸晃; 産形 和央; 臼井 伸一; 藤野 育男;
		越智 隆夫; 本宮 照久; 高梨 憲通; 朝日 伸光;
		高橋一郎;吉澤弘司
IV-2-1 en	Name(s)	KATO, Nobuaki; UBUKATA, Kazuo; USUI, Shinichi;
		FUJINO, Ikuo; OCHI, Takao; MOTOMIYA, Teruhisa;
		TAKANASHI, Norimichi; ASAHI, Nobumitsu;
		TAKAHASHI, Seiichiro; YOSHIZAWA, Hiroshi
V	国の指定	
Y-1	広域特許 (他の種類の保護又は取扱いを	AP: GH GM KE LS MW MZ SD SL SZ TZ UG ZM ZW
	求める場合には括弧内に記載す	及びハラレプロトコルと特許協力条約の締約国であ
	3.)	る他の国 EA: AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM
		BO NO
		一ある他の国
		EP: AT BE BG CH&LI CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
		GR HU IE IT LU MC NL PT SE SI SK TR
		及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国で
		ある他の国
		OA: BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN
		TD TG
		及びアフリカ知的所有権機構と特許協力条約の締約
V-2	国内特許	国である他の国 AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA
• =	(他の種類の保護又は取扱いを	CH&LI CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE ES FI
	求める場合には括弧内に記載す	GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS KE KG KP KR
	る。)	KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX
		MZ NI NO NZ OM PH PL PT RO RU SC SD SE SG SK
		SL TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA
		ZM ZW
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

特許協力条約に基づく国際出願願書

V-5 指定の確認の宣言 出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9(b)の規定に基づき、 特許協力条約のもとで認められ る他の全ての国の指定を行う。 ただし、V-6欄に示した国の指 定を除く。出願人は、これらの 追加される指定が確認を条件と 担加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げるであるとみなされる とを宣言する。 V-6 指定の確認から除かれる国 なし (NONE) VI-1 先の国内出願に基づく優先権 主張 VI-1-1 出願日 2002年04月01日 (01.04.2002) VI-1-2 出願番号 特願2002-098299 VI-1-3 国名 日本国 JP VI-2 優先権証明書送付の請求 上記の先の出願のうち、右記の VI-1 番号のものについては、出願書類の認証謄本を作成し国際事務 局へ送付することを、受理官庁に対して請求している。 VI 1-1 特定された国際調査機関(ISA 日本国特許庁 (ISA/JP) VIII 申立て数 申立て VIII-1 発明者の特定に関する申立て VIII-2 出願し及び特許を与えられる国 際出願日における出願人の資格 に関する申立て 先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て VIII-3 発明者である旨の申立て (米国 を指定国とする場合) VIII-4 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て VIII-5 TX 照合欄 用紙の枚数 添付された電子データ IX-I 願書(申立てを含む) 5 1X-2 明細書 11 1X-3 請求の範囲 2 1X-4 要約 1 **EZABSTOO. TXT** IX-5 図面 6 1X-7 合計 25 添付 添付された電子データ 添付書類 IX-8 手数料計算用紙 IX-9 個別の委任状の原本 IX-17 PCT-EASYディスク フレキシブ ルディスク 1X-18 その他 納付する手数料に相当す る特許印紙を貼付した書 面 IX-18 その他 国際事務局の口座への振 込みを証明する書面

5/5 特許協力条約に基づく国際出願顧書 CF017145WO 原本(出願用) - 印刷日時 2003年03月27日 (27.03.2003) 木曜日 18時27分25秒						
IX-19	要約書とともに提示する図の 番号	Fig. 3				
11-20	国際出願の使用言語名:	日本語				
X-1 X-1-1	提出者の記名押印 氏名(姓名)	岩井 一 に は に に に に に に に に に に に に に				
	【八石(姓名)	日井 伸一				
受理官庁記入欄						
10-1	国際出願として提出された書 類の実際の受理の日					
10-2	図面:					
10-2-1	受理された					
10-2-2	不足図面がある					
10-3	国際出願として提出された書 類を補完する書類又は図面で あってその後期間内に提出さ れたものの実際の受理の日(訂正日)					
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づ く必要な補完の期間内の受理 の日	·				
10-5	出願人により特定された国際 調査機関	ISA/JP				
10-6	調査手数料未払いにつき、国 際調査機関に調査用写しを送 付していない					

国際事務局記入欄

11-1

記録原本の受理の日

明細書

導電性部材及びその製造方法

5 技術分野

本発明は、液相から導電膜を形成する導電性部材、具体的には、配線 及び端子に利用できる金属導電膜等を有する導電性部材や、優れた導電 性を有する有機半導体素子等の導電性部材の製造方法及び該方法により 得られた導電性部材に関する。

10

15

20

25

背景技術

従来より、半導体素子等の電子デバイスにおける種々の機能膜(導電膜や絶縁膜等の薄膜)を形成する方法としては、真空プロセス、例えば、真空蒸着法、化学気相成長法(CVD)、スパッタリング法等が採用されている。これらのプロセスでは、真空を形成する必要があるため、装置が大型化し、煩雑となることが多いため、より簡易に且つ高性能の薄膜形成プロセスが要望されていた。

更に特開2001-234356号公報は、基材上にコロイド層を形成し、該コロイド層の表面に、該基材より該コロイド層で大きな吸収強度となるエネルギー線を照射することにより導電性に優れた導電膜を製造する方法を開示し、実施例では、ガラス基板上に銀コロイド水溶液を滴下し、スピンコート法で塗布する方法が記載されている。しかし本発明者らの検討によれば、先ず得られる導電膜と基材との間の密着性が十分でなく、当該導電膜のデバイスへの応用を考慮すると、該導電膜と基材との密着性を向上させる必要があるとの認識を得た。また、同号公報には、コロイド溶液をインクジェット記録ヘッドを用いて基材上に付与

することが記載されているものの、本発明者らの検討によれば、同号公報に記載の技術を用いて基材上に精細な導電パターンを形成するのは極めて困難であった。

従って本発明の目的は、簡易な装置及び方法により良好な特性の膜(薄膜)を有する導電性部材の製造方法及び良好な特性の膜を有する導電性部材を提供することにある。

発明の開示

5

10

15

20

25

上記目的は、以下の本発明によって達成される。即ち、本発明は、基材表面に導電膜を具備している導電性部材の製造方法であって、(i)少なくとも多孔性表面を有している基材(以下単に「基材」という)の、該多孔性表面にコロイド溶液を適用してコロイドを含む層を形成する工程と、(ii)該コロイドを含む層を乾燥して導電膜とする工程、とを有することを特徴とする導電性部材の製造方法を提供する。

上記本発明においては、前記コロイドが、金属コロイドであること; 前記金属が、銀、金、白金又はパラジウムであること;前記コロイド溶 液を、スピンコート法で前記多孔性表面に適用して前記コロイドを含む 層を形成する工程を有すること;前記コロイドを含む層を、前記多孔性 表面に位置選択的に形成する工程を有すること;前記コロイド溶液をイ ンクジェット法で前記多孔性表面に適用して前記コロイドを含む層を位 置選択的に形成すること;及び多孔性表面の該表面を含む表面近傍が、 疑べーマイト構造を有していることが好ましい。

また、上記本発明においては、前記金属コロイドの平均粒径をφ1 ave とし、前記多孔性表面の平均細孔径をφ2 ave としたときに、下記の条件を満たしている前記の導電性部材の製造方法を提供する。

 ϕ 1 ave $\geq \phi$ 2 ave

また、本発明は、前記本発明の方法で製造されたことを特徴とする導電性部材;基材の多孔性表面に導電性膜を具備している導電性部材であって、該導電性膜がコロイド粒子を含む湿式塗布膜の乾燥膜であることを特徴とする導電性部材を提供し、該導電性部材における導電膜は、有機半導体との接触部位を有していてもよい。

本発明者らは、

5

1;金属コロイド溶液を塗布し、吸収及び乾燥することで、金属コロイド粒子の周囲に元々存在する有機物を除去して、金属粒子-金属粒子コンタクトを形成する。

10 2;基材上に多孔性の吸収層を設けることで、金属コロイド粒子の保持 を確実にし、高精細なパターンを作成する。

以上の対応にて、前記課題を解決し得ることを知見したものである。

図面の簡単な説明

15 図1は、金属コロイド粒子の周囲に有機物が付着している状態を示す図である。

図2は、金属コロイド溶液が多孔性表面に付与された状態を示す図である。

図3は、有機物及び媒体が除去された状態を示す図である。

20 図4は、電気回路パターンの図である。

図5は、図4中の電極部A及びBを線分abで切断した断面図である。

図6は、オーブンで乾燥させた後の状態を示す図である。

図7は、電界効果型(FET)トランジスタを示す図である。

図8は、図7中の線分abで切断した断面図である。

25 図9は、オーブンで乾燥させた後の状態を示す図である。

図10は、FETを示す図である。

図11は、FETの静特性を測定した結果を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

以下に好ましい実施の形態を挙げて本発明を更に詳細に説明する。

5 (導電性部材の製造方法)

10

15

20

25

以下、本発明の導電性部材の製造方法について詳細に説明する。本発明にかかる導電性部材の製造方法は、基材の多孔性表面にコロイド溶液を適用し、コロイドを含む層を形成し、該コロイドを含む層を乾燥して導電性部材とする工程を含む。この方法によれば、大型の装置や煩雑な方法によらずとも、良好な導電性の膜を有する導電性部材が得られる。そして、本発明においては、特に、前記コロイドとして金属コロイドを用いることで、特に導電性に優れ、また精細なパターン状の導電膜を有する導電性部材を安価に製造することができる。

以下、本発明にかかる導電性部材の製造方法の好ましい実施形態として、上記の金属コロイド溶液を用いた導電性部材の製造方法の例を詳述する。金属コロイド溶液は、一般に、コロイド粒子の安定化のために、図1に示すように、金属コロイド粒子1の周囲に有機物2が付着している。ここで、有機物2の例としては、クエン酸、PVP(ポリ(Nービニルー2ーピロリドン))、MMS-NVP(メルカプトメチルスチレン-Nービニルー2ーピロリドン)共重合体、ポリアクリロニトリル等が挙げられる。3は金属コロイド粒子1を分散するための液媒体であり、有機溶媒から水まで選択可能である。

本実施形態においては、基材6の多孔性表面に、金属コロイド溶液を適用すると、図2に示すように、金属コロイドを含む層A(未処理、即ち後述する乾燥前)は、多孔性表面5上で、金属コロイド粒子1が、多孔性表面による液媒体の吸収により液媒体3から分離したような状態と

なっている。そして、かかる状態の金属コロイドを含む層 A 中の液媒体の乾燥と多孔性表面による吸収とにより、金属コロイドを含む層 A における有機物 2 及び液媒体 3 が除去され、乾燥後には、図 3 に示すように金属コロイド粒子 1 間に強い接触状態が形成されている層 B を形成することができる。6 は例えば P E T (ポリエチレンテレフタレート) や紙等からなる基材である。

5

10

15

20

図3は、金属コロイド粒子1間に強い接触が形成された層 B が形成されている状態を模式的に示したものである。同図3において、有機物2及び液媒体3は吸収及び乾燥で除去され、金属コロイド粒子1のうちの粒径の小さいものは、多孔性表面5の穴4に落ち込み、多孔性表面5上の金属コロイド粒子1と結びつく。その結果、層 B と多孔性表面5 との間には強力なアンカー効果が働き、層 B が、多孔性表面5から剥離することを極めて有効に抑えることができる。言い換えれば、層 B と多孔性表面5 との密着性を向上させることができる。

以上の方法によれば、導電性が高く、且つ多孔性表面5に対して密着性に優れた導電膜Bを備えた導電性部材が得られるという優れた効果を有するものとなる。また、本実施形態においては、前記吸収及び乾燥による有機物と媒体の除去を同時に行うことができるため、処理される基材に影響を与えずに、基材表面に所望の導電膜を形成することができる。

乾燥方法としては、熱風、近赤外光線、赤外線及び遠赤外線の照射等が挙げられる。そして、金属コロイドを含む層の表面を乾燥する装置としては、例えば、乾燥炉、オーブン、キセノンランプ、ハロゲンランプ、水銀灯又はそれぞれのランプにフィルターを装着したもの等が挙げられ、特にオーブンが好ましい。

25 基材上への金属コロイドを含む層の形成は、金属コロイドが液媒体に 分散されているコロイド溶液を、定法、例えばスピンコート法、インク ジェット記録用ヘッドを用いる方法、ディップによる成膜法又はブレードコート法等により、多孔性表面 5 に適用することで行われる。特に、スピンコート法又はインクジェット記録用ヘッドを用いる成膜法により行われることが好ましい。

5

10

15

20

25

本実施形態においては、コロイド溶液の多孔性表面への適用、並びに その結果として形成されるコロイドを含む層の乾燥により導電膜が形成 されるため、コロイドの材料としては、広範な種々の金属を用いること ができる。従って、前記金属コロイドに用いられる金属としては、特に 制限されず、例えば、銀、金、白金、パラジウム及びニッケル等が挙げ られ、中でも、銀、金、白金及びパラジウムが安定性の点で好ましい。 また、前記金属コロイド層の厚みは、特に制限されないが、通常、

 $0.1 \sim 5 \mu m$ 、好ましくは $0.5 \sim 2 \mu m$ とする。

本実施形態に使用される、前記金属コロイドを含む層を形成するための基材としては、例えば、ガラス基板、ポリアニリン、ポリエステル等の高分子基板、紙、PET等の可撓性の材料が挙げられる。そして、これらの基材上に例えば後述する様に擬ベーマイト構造のアルミナ水和物を含む多孔質層を形成することで、多孔性表面を担持させる。擬ベーマイト構造のアルミナ水和物を含む多孔質層の製造方法は、例えば特開2000・318308号公報に詳細に記載されている。

本発明においては、このように多孔性表面を備えた基材上にコロイド 溶液を適用することで、前記した様に導電膜と基材との間のアンカー効果により導電膜の基材に対する密着性を格段に向上させることができる。また、コロイド溶液中の液媒体が多孔性表面に吸収される為に、例えばコロイド溶液をインクジェット記録ヘッドなどの液滴付与手段を用いて微細なパターン状に付与した場合にも液滴が基材上で無秩序に拡がることがない。その結果、基材表面にパターン状の撥水処理や親水処理等の 前処理を施さなくても、精細な導電性パターンを備えた導電性部材を得ることができる。

本実施形態の製造方法によれば、導電性に優れた金属導電膜を有する 導電性部材を容易に且つ安価に得ることができる。

また、本発明にかかる導電性部材の製造方法は、前述した好ましい実施形態に限定されず、例えば、コロイド層として、前記金属コロイド層の代わりに、セレン化カドミウム、硫化カドミウム及び酸化チタン等の半導体コロイド層等を用い、半導体膜等の良好な特性の膜(薄膜)を有する導電性部材を製造する方法の形態とすることも可能である。

10 (金属導電膜)

5

15

20

25

本発明に係る導電性部材は、その好ましい実施形態として、前述したような製造方法により得られる金属導電膜を有する導電性部材が挙げられる。本実施形態の導電性部材の導電膜は、それを構成する金属コロイド粒子の粒径が、 $5\sim1000$ nm、特に $200\sim500$ nm程度のものである。

また、本実施形態の導電性部材の導電膜の厚みは、特に制限されないが、 $0.1\sim5\,\mu\,m$ 、特に $0.5\sim2\,\mu\,m$ 程度である。また、多孔性吸収層の厚みはおよそ $30\,\mu\,m$ である。

本実施形態の導電膜を有する導電性部材は、例えば、配線、端子の他に、水素吸蔵デバイス等の用途に利用できる。特に、本実施形態の導電膜を有する導電性部材は、前述の通り優れた導電性を有するため、主として配線及び端子に好適に利用できる。

また、本発明の導電性部材の膜は、前述した好ましい実施形態としての導電膜に限定されず、他の機能薄膜の形態とすることもでき、例えば、有機半導体素子や、他の機能デバイスにおける機能薄膜等の用途にも利用できる。

【実施例】

以下、実施例により本発明の導電性部材の製造方法及び該方法による 導電性部材の説明を更に詳細に説明する。しかしながら、本発明は、これらの実施例により何等制限されるものではない。

5 〔実施例1〕

20

図1に示すように有機物2で保護された銀コロイド粒子の直径を ϕ 1 ave とし、該銀コロイド粒子の平均粒径を ϕ 1 ave とした場合、本実施例では ϕ 1 ave は、マイクロトラック社製の粒度分布測定機で測定したところ、10nmであった。

次に銀コロイド溶液をキヤノン製のインクジェットプリンタ「BJC 600」の空のインクタンクに注入し、A4サイズの光沢紙「PR10 1」上に、図4に示す電気回路パターンを印刷した。次いで該光沢紙をオーブンで150℃で30分間乾燥させ、パターンの定着を行った。該光沢紙は、基紙上に擬ベーマイト構造のアルミナ水和物を含む多孔質のインク受理層を有している。こうして得られた印刷物について、図4中の電極部A及びBを線分abで切断した断面図であるところの図5を用いて詳細に説明を行う。

図5中のA及びBはそれぞれ図4における電極部分A及びBに対応し、プリンタで印刷された直後の様子を示している。5は多孔性吸収層であるところの、擬ベーマイト構造のアルミナ水和物を含むインク受理層(多孔性表面)である。これらの擬ベーマイトは、アルミニウムアルコキシドの加水分解やアルミン酸ナトリウムの加水分解等の公知の方法で製造することができる。

また、そこから作られた擬ベーマイトを塗工液として用いて作成した 25 記録媒体の場合、従来の記録媒体に比べてインク中の染料の定着が良く、 発色性の高い画像を得ることができることが、特開2000-3183 0.8号公報に開示されている。 $\phi.2$ は、疑ベーマイト構造中の細孔径であり、その断面を電子顕微鏡で観察して算出した平均径 $\phi.2$ ave は、およそ1.0 n m である。

このような構成になっているので、プリンタヘッドから吐出された銀コロイド溶液は、電極パターンA及びBに着弾した直後に溶媒(この場合水)はすぐ下の多孔性吸収層に浸み込み、横方向へ滲むことがなく、電極パターンが繋がってしまうことも防止できるようになった。また、この媒体の浸み込みによって、有機物の大部分がコロイド粒子から分離除去される。

図6は、図5に示したコロイドを含有する電極パターンA及びBを有する基材を、オーブンで150℃、30分間乾燥させた後の状態を示す図である。ここでは図5中の有機物2や液媒体3は多孔質表面への吸収、空気中への蒸発等により多孔質表面には残っていない。また、ここで銀コロイド粒子の平均粒径と疑べーマイト層の平均細孔径には下記の関係がある。

ϕ 1 ave $\geq \phi$ 2 ave

5

10

15

20

25

従って、銀コロイド粒子の一部は、疑ベーマイト層の細孔に嵌り込み、アンカー効果として電極パターンの定着性の向上に効果がある。同時に銀コロイド粒子は、疑ベーマイト層の細孔より大きいので、そこを潜り抜け、粒子同士が連なって電極Aと電極Bを導通させることもなかった。(導電性評価)

また、得られた銀導電膜について、テスターによる抵抗値の測定により、導電率(導電性)を評価した。その結果、図4中のA-B間の抵抗値は6 Ω 、B-C間は18 Ω であり、導電性に優れたものであった。このように、テスターという最も初歩的で且つ接触抵抗の大きな実験条件の中で、乾燥後でこれだけの小さな抵抗値が出ており、十分に実用に耐

え得るといえる。

〔実施例2〕

5

10

15

20

図7は、本発明を利用して得られた導電性部材としての電界効果型(FET)トランジスタの平面図である。図7中、A及びBは、前記プリンタで印刷した櫛形電極である。12は撥水性の絶縁部であり、電極A(ソース)及びB(ドレイン)の印刷の前に予めオフセット印刷で形成しておいたものである。材料はポリイミドであり、日産化学の「RN-812」を用いた。これにより電極間ギャップが保たれるのである。因にチャネル長は $L=100\mu$ m、チャネル幅W=4mm×30本である。線分abで切断した断面が図8である。

図8において、7は電極A(ソース)であり、8は電極B(ドレイン)である。絶縁部12の下部は多孔性吸収層5の細孔4に侵入し、確実にアンカー効果を演じている。図8は、プリンタでコロイド溶液が印刷された直後の様子を示している。このような構成になっているので、プリンタヘッドから吐出された銀コロイド溶液は電極パターンA及びBに着弾した直後に液媒体(この場合水)及び媒体中に溶解している有機物はすぐ下の多孔性吸収層に染込み、横方向へ滲むことがなく、電極パターンが繋がってしまうこともない。更に12は撥水性であるので、電極間ギャップは12の印刷精度で決まり、100μmのチャンネル長が作成できた。

図9は、図8に示したコロイドを含有する電極A、Bを有する基材をオーブンで150℃、30分間乾燥させた後の状態を示す図である。ここでは図8中の有機物2及び液媒体3は、多孔性吸収層に吸収され、或いは空気中に蒸発してしまい、多孔質表面には残っていない。

25 図10において、9は銅フタロシアニンの有機半導体を蒸着したものである。10は絶縁層であり、12と同じ日産化学の「RN-812」

をスピンコートでコートした。11はゲート電極であり、7、8と同じように銀コロイド溶液をインクジェットプリンタを用いて付与して形成したものである。

上記FETの静特性(準静的にゲート電圧Vgを変化させたときのドレイン・ソース間電圧Vdsに対応するドレイン・ソース間電流Ids)を測定した結果を図11に示す。この結果からも明らかなように、シリコンFETに比べれば性能は劣るが、使用範囲を限定すればFETとして使える可能性がある。

〔実施例3〕

5

20

25

10 実施例1において、銀に代えて、金、白金又はパラジウムを用いて、 それぞれ実施例1と同様にして、金導電膜、白金導電膜及びパラジウム 導電膜を有する導電性部材を形成した。得られた導電性部材の両導電膜 について、実施例1と同様の評価をしたところ、何れの導電膜も、実施 例1と同様の優れた効果が得られた。

15 〔実施例 4〕

金属コロイド層を形成する際の成膜法を、インクジェット記録用ヘッドを用いる方法に代えて、スピンコート法、オフセット印刷又はシルク印刷を用いた以外は実施例1と同様にして、銀導電膜を有する導電性部材を形成した。そして、この導電膜について実施例1と同様の評価をしたところ、実施例1と同様の優れた効果が得られた。

産業上の利用の可能性

本発明によれば、良好な特性の膜(薄膜)を有する導電性部材を提供することができる。特に、膜を液相から形成でき、吸収及び乾燥により有機物及び溶媒の除去が簡単にできるため、容易に且つ安価に、導電性に優れた金属導電膜を有する導電性部材及び有機半導体素子を提供することができる。

請求の範囲

- 1. 基材表面に導電膜を具備している導電性部材の製造方法であって、(i)少なくとも多孔性表面を有している基材の、該多孔性表面にコロイド溶液を適用してコロイドを含む層を形成する工程と、(ii)該コロイドを含む層を乾燥して導電膜とする工程、とを有することを特徴とする導電性部材の製造方法。
- 2. 前記コロイドが、金属コロイドである請求項1に記載の導電性部 材の製造方法。
 - 3. 前記金属が、銀、金、白金又はパラジウムである請求項1に記載の導電性部材の製造方法。
- 4. 前記コロイド溶液を、スピンコート法で前記多孔性表面に適用して前記コロイドを含む層を形成する工程を有する請求項1に記載の導電性部材の製造方法。
- 5. 前記コロイドを含む層を、前記多孔性表面に位置選択的に形成す 20 る工程を有する請求項1に記載の導電性部材の製造方法。
 - 6. 前記コロイド溶液を、インクジェット法で前記多孔性表面に適用 して前記コロイドを含む層を位置選択的に形成する請求項1又 は5に記載の導電性部材の製造方法。

7. 前記多孔性表面の該表面を含む表面近傍が、疑べーマイト構造を

25

5

有している請求項1~6の何れか1項に記載の導電性部材の製造方法。

- 8. 前記金属コロイドの平均粒径を ϕ 1 ave とし、前記多孔性表面の平均細孔径を ϕ 2 ave としたときに、下記の条件を満たしている請求項 $1\sim7$ の何れか1項に記載の導電性部材の製造方法。 ϕ 1 ave $\geq \phi$ 2 ave
- - 10. 基材の多孔性表面に導電性膜を具備している導電性部材であって、該導電性膜がコロイド粒子を含む湿式塗布膜の乾燥膜であることを特徴とする導電性部材。

11. 前記導電膜が、有機半導体と接触している部位を有している請求項9又は10に記載の導電性部材。

15

5

要 約 書

優れた特性を示す導電性部材の製造方法並びに導電性部材の提供。基 材表面に導電膜を具備している導電性部材の製造方法であって、(i) 少なくとも多孔性表面を有している基材の、該多孔性表面にコロイド溶 液を適用してコロイドを含む層を形成する工程と、(ii)該コロイドを 含む層を乾燥して導電膜とする工程、とを有する。

5

FIG. 1

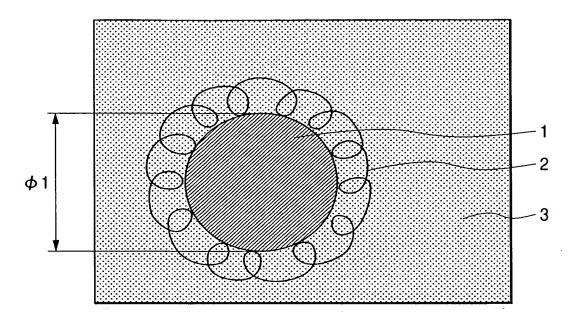


FIG. 2

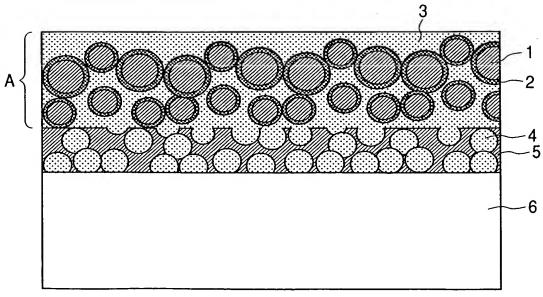


FIG. 3

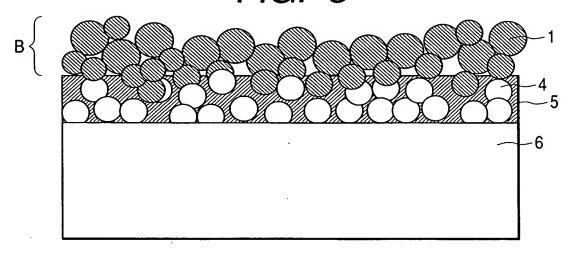


FIG. 4

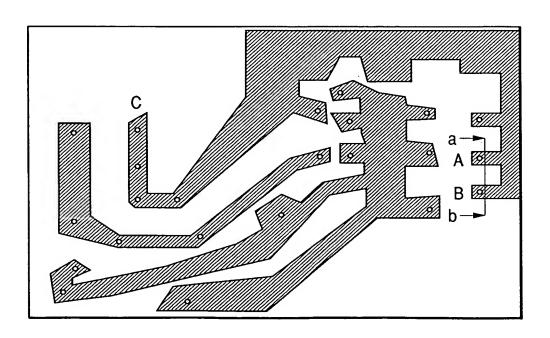


FIG. 5

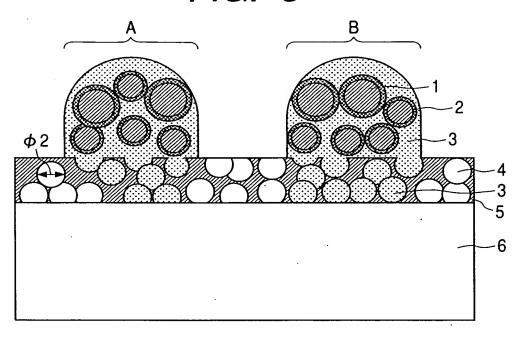


FIG. 6

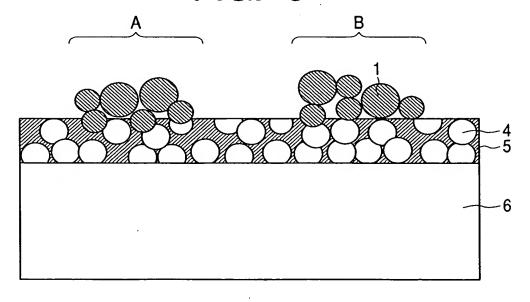


FIG. 7

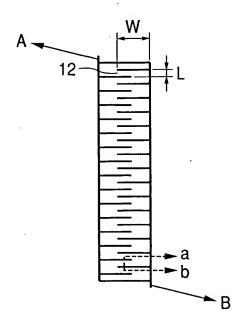


FIG. 8

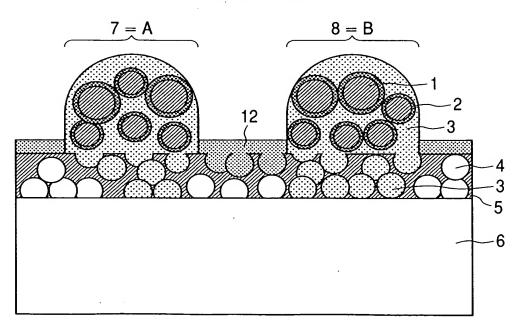


FIG. 9

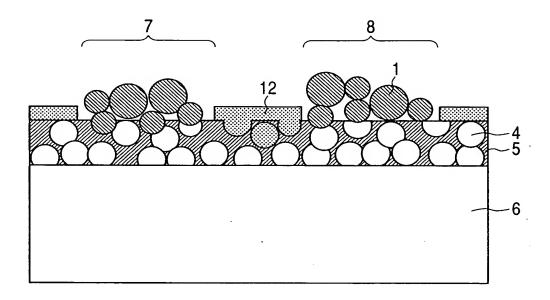


FIG. 10

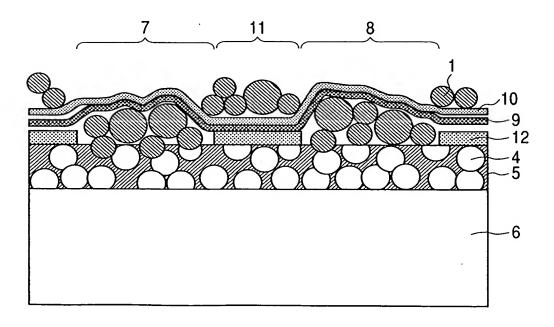


FIG. 11

